

4月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

洞察行情 精准决策

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情、市场重点趋势等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子订阅号，及时获取报告发布等信息。您可以通过联系安芯易客户经理或通过 marketing@360ic.com 获取完整版报告。

目录

摘要	1
一、宏观动态	2
（一）经济景气跟踪	2
（二）行业需求动态	2
（三）突发事件分析	4
（四）资本市场动态	4
（五）产业政策动态	5
二、半导体产业动态	6
（一）短期影响	7
（二）中期影响	7
（三）长期影响	8
三、终端市场动态	9
（一）人工智能	9
（二）新能源	10
（三）汽车	10
（四）其他	10
四、重点产品行情	11
（一）存储芯片：终端需求增长放缓，现货价格增长动力不足	11
（二）MCU：低端型号市价倒挂，车规类器件货期较长且稳定	11
（三）模拟芯片：受益于消费电子市场弱复苏，Q2 订单有望恢复	12
五、市场重点趋势	12
信息来源	14
免责声明	15

摘要

2024 年 4 月重点行情趋势	
宏观趋势	- 中国制造业恢复发展，生产指数上升至 52.9 - 全球半导体市场需求增长放缓，3 月销售额继续环比下滑
产业动态	- 存储原厂继续调涨产品价格，看好存储芯片未来需求增长 - 三星加码投资 AI 芯片设计，或将影响 AI 芯片行业格局
终端市场	- 人工智能：SoftBank 拟投资 9.6 亿美元发展 AI 数据中心，AI 芯片需求有望持续增长 - 新能源：晶澳科技与比亚迪达成战略合作，国内储能产业发展加速 - 汽车：Mobileye 自驾芯片接单量已达 4600 万颗，智能汽车有望加快发展 - 其他：华为 Pura 70 销售火热，关注华为手机产业链机会
产品行情	- 存储芯片：终端需求仍然疲软，现货价格成长动能放缓 - MCU：低端型号市场价倒挂，车规类器件交期仍较长 - 模拟芯片：Q2 订单有望修复，主要系消费电子市场弱复苏所带动

一、宏观动态

(一) 经济景气跟踪

● 中国制造业恢复发展，美国制造业 PMI 则大幅回落

24 年 4 月，根据 JP Morgan 数据，全球制造业 PMI 为 50.3，仍处于扩张区间。

分区域来看：

亚洲方面，中国地区制造业 PMI 为 50.4，连续两个月位于扩张区间，制造业维持恢复发展态势，其中生产指数为 52.9（环比上升 0.7pct），尤其是计算机通信电子设备等行业生产指数均位于 55.0 以上，企业生产扩张加快、产能释放较快；高技术制造业 PMI 为 53.0，高端制造业保持较快发展。日本制造业 PMI 有所回升，但仍处于萎缩区间；韩国则继续小幅下滑。印度制造业 PMI 延续扩张态势；越南制造业 PMI 回升至 50.3，主要系新订单有所恢复。

美洲方面，美国 ISM 制造业 PMI 回落至 49.2，主要系新订单及生产指数有所下滑。墨西哥制造业 PMI 为 51.0，延续扩张态势。

欧洲方面，欧元区制造业 PMI 继续下滑至 45.7，主要系订单需求下滑。

全球各地区制造业 PMI

时间	全球	中国	日本	韩国	印度	越南	美国	墨西哥	欧元区
2023-04	49.60	49.20	49.50	48.10	57.20	46.70	47.10	51.00	45.80
2023-05	49.60	48.80	50.60	48.40	58.70	45.30	46.90	50.50	44.80
2023-06	48.80	49.00	49.80	47.80	57.80	46.20	46.00	50.90	43.40
2023-07	48.70	49.30	49.60	49.40	57.70	48.70	46.40	53.20	42.70
2023-08	49.00	49.70	49.60	48.90	58.60	50.50	47.60	51.20	43.50
2023-09	49.10	50.20	48.50	49.90	57.50	49.70	49.00	49.80	43.40
2023-10	48.80	49.50	48.70	49.80	55.50	49.60	46.70	52.10	43.10
2023-11	49.30	49.40	48.30	50.00	56.00	47.30	46.70	52.50	44.20
2023-12	49.00	49.00	47.90	49.90	54.90	48.90	47.40	52.00	44.40
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	50.30	49.10	50.20	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	50.40	47.80	52.30	46.50
2024-03	50.60	50.80	48.20	49.80	59.10	49.90	50.30	52.20	46.10
2024-04	50.30	50.40	49.60	49.40	58.80	50.30	49.20	51.00	45.70

数据来源：FastBull

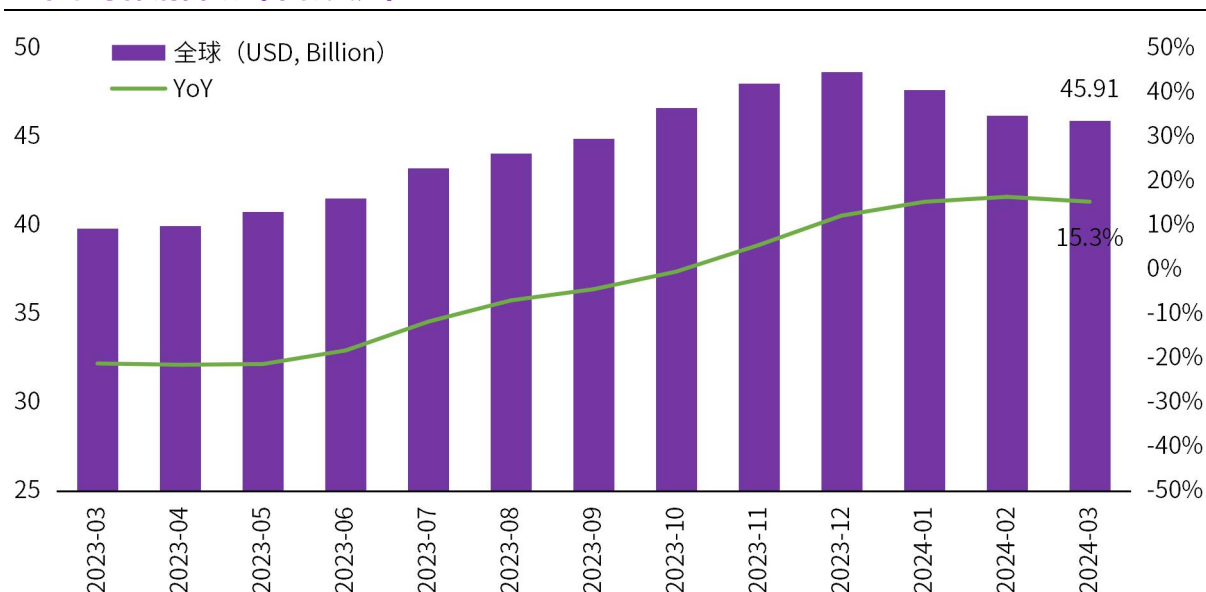
(二) 行业需求动态

● 受宏观经济波动影响，全球半导体市场需求增长放缓

24 年 3 月，全球半导体销售额继续呈现季节性调整趋势，环比下滑约 0.6%。从 24 年 Q1

来看，全球半导体销售额累计达 1397.1 亿美元，累计同增 15.6%，增速有所放缓。

全球半导体销售额（十亿美元）



数据来源：SIA

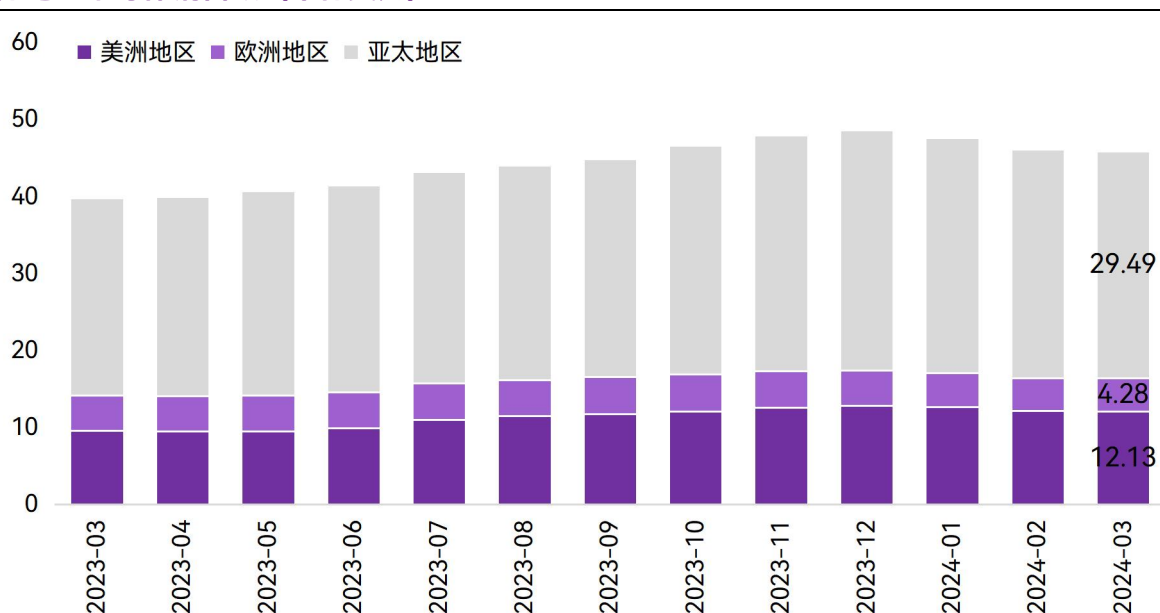
分区域来看：

亚太地区，3 月整体表现平淡，销售额为 294.9 亿美元（同比+15.1%）；Q1 累计销售额为 897.7 亿美元（累计同比+16.2%）。其中，中国地区 3 月销售额达 141.4 亿美元，与上月持平。日本地区需求持续低迷，3 月同比下降 9.3%。

美洲地区，市场需求表现同比修复较快，3 月销售额 121.3 亿美元，同比增长 26.2%。

欧洲地区，市场相对疲软，销售额同比降幅继续扩大（-7.0%），制造业表现较差。

分地区半导体销售额（十亿美元）



数据来源：SIA

(三) 突发事件分析

4月3日7时58分在台湾花莲县海域发生7.3级地震。根据 TrendForce 研究报告（4月10日），各厂商所需检修及报废晶圆数量不一，且厂房设备本身抗震能力均能达到一定的抗震效果，Micron（美光）、Nanya Technology（南亚科技）、PSMC（力积电）、Winbond（华邦电子）等均大致恢复 100%的产线运作，估计本次地震对第二季 DRAM 产出位元影响仍可控制在 1%以内。另外，市场传出有 PC OEM 供应商出于特殊考量，接受高昂的 DRAM 及 NAND Flash 合约价涨幅，但仅是零星成交情况。

厂商	地点	受影响情况	复工进程
Micron (美光)	桃园	桃园厂报废片数比例超 60%	4月8日早上约 80%复工，4月10日前恢复 100%生产
	台中		4月8日已恢复 100%生产
Nanya Technology (南亚科技)	新北	考虑机台无法负荷，多数晶圆仍需检查	4月8日已恢复 100%生产
Winbond (华邦电子)	台中	晶圆受损数量约占第二季度产出 1%	4月8日已恢复 100%生产
PSMC (力积电)	新竹	P3 厂区受影响程度大	4月8日早上 90%复工，当日已恢复 100%生产

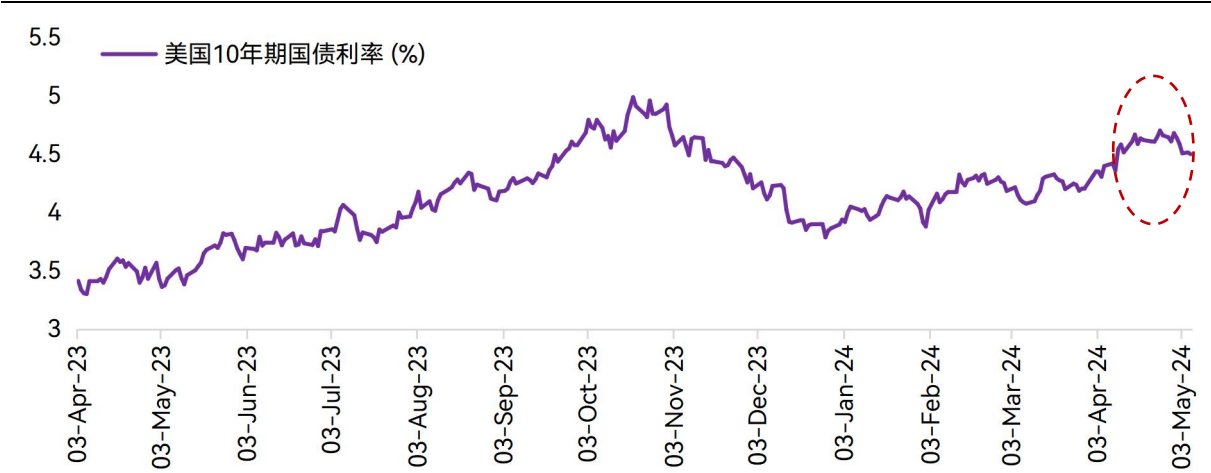
数据来源：TrendForce

(四) 资本市场动态

● 美国 10 年期国债利率月内继续上升，关注进出口贸易汇率风险

24 年 4 月，美国 10 年期国债利率继续上升，主要系美联储确认延期降息，持续关注进出口贸易汇率风险。

美国 10 年期国债利率(%)



数据来源：MacroMicro

● 受美国经济预期影响，费城半导体指数月内大幅波动

受美联储宣布推迟降息影响，费城半导体指数（SOX）于4月中旬大幅下跌；但在美国公布就业数据后，由于失业率攀升，市场对美联储降息预期或将回温，费城半导体指数继续回升。

费城半导体指数（SOX）



数据来源：MacroMicro

（五）产业政策动态

● 马来西亚规划东南亚最大集成电路设计园区，加速发展半导体产业

据路透社消息，马来西亚政府于4月22日宣布，计划打造东南亚最大的集成电路设计园区，旨在将吉隆坡塑造为区域数字中心。为此，政府将推出一系列激励措施，包括税收减免、补贴及免签证费等，以吸引全球科技公司与投资者。

● 美国将与阿联酋合作发展 AI 产业，或将影响 AI 产业格局

拜登政府积极推动美国科技集团在阿联酋寻找人工智能的交易和合作机会。4月15日，Microsoft（微软）宣布向阿布扎比的人工智能集团 G42 投资 15 亿美元。《华盛顿邮报》报道，作为谈判的一部分，G42 已同意从中国撤资、将中国设备从其业务中剔除，其中包括华为。

● 法国补贴本土太阳能电池板，影响中国光伏厂商出海进程

本月，法国经济和财政部部长勒梅尔在参观光伏园区时宣布，法国将通过提供补贴、修订碳含量标准等方式支持法国国产太阳能电池板，以削弱中国光伏制造商在欧洲占据的主导地位。

● 日本将收紧对更多芯片和量子技术的出口管制，可能影响相关芯片厂商

日本表示计划扩大对与半导体和量子计算相关的四种技术的出口限制，将影响用于分析纳米粒子图像的扫描电子显微镜，以及全环绕栅极晶体管技术（被三星采用）。日本还将要求出

口低温 CMOS 电路（用于量子计算机）及出口量子计算机本身须获得许可。

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
短期影响	Western Digital (西部数据)	确认 HDD 和 SSD 出现供应短缺，继续调整闪存和硬盘产品价格	闪存及硬盘产品价格或将调涨
	Samsung (三星)	将于 Q2 量产 12 层 HBM3E（搭载于 AMD 芯片中）	加速追赶 SK Hynix，存储厂商格局持续演变
	Samsung (三星)	Q2 月均 DRAM 晶圆投入量增至 60 万片，下半年预计增至 66 万片	看好 DRAM 需求增长
	Micron (美光)	计划 Q2 针对 DRAM 内存和 SSD（固态硬盘）产品调涨 25%	内存及硬盘产品价格或将调涨
	SK Hynix (SK 海力士)	Q2 月均 DRAM 晶圆投入量增至 41 万片；下半年预计增至 45 万片	看好 DRAM 需求增长
中期影响	Marvell (美满电子)	已从三家美国大型云计算公司获得新 AI 芯片订单	AI 芯片市场竞争加剧
	Quanta (广达)	搭载 NVIDIA GB200 的服务器将于 9 月量产	看好 AI 服务器需求增长
	HANMI Semiconductor (韩美半导体)	从 Micron（美光科技）获得价值 226 亿韩元订单，将提供用于制造 HBM 芯片的 TC 键合机	看好 HBM 需求增长
长期影响	Samsung (三星)	通过旗下三星综合研究院在美国硅谷开设面向人工智能芯片设计的先进处理器实验室	AI 芯片市场竞争加剧
	SK Hynix (SK 海力士)	将与 TSMC 合作量产 HBM4 芯片	看好 HBM 需求增长
	SK Hynix (SK 海力士)	拟斥资约 20 万亿韩元在韩国构建新的存储芯片产能，以满足人工智能需求	看好 AI 需求长期增长
	ROHM (罗姆)	旗下 SiCrystal 将扩大向 ST（意法半导体）长期供应的 150mm SiC 晶圆合同	看好 SiC 需求增长
	Microchip (微芯科技)	宣布收购 Neuronix AI Labs，以进一步增强在 FPGA 上部署 AI 边缘解决方案的能力	看好 AI 需求增长
	Infineon (英飞凌)	与 Amkor 合作运营芯片封测中心	巩固欧洲半导体供应链

（一）短期影响

- **Western Digital 确认 HDD 和 SSD 出现供应短缺，继续调整闪存和硬盘产品价格**

Western Digital（西部数据）4 月 8 日首次确认 HDD 和 SSD 均出现供应短缺。公司发出正式客户信函，通知 NAND 闪存和硬盘产品正在进行价格调整。西部数据表示，闪存和硬盘产品的需求均超出预期，导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格，部分调整将立即生效。

- **Samsung 将于今年 Q2 量产 HBM3E，存储芯片厂商格局将持续演变**

Samsung（三星）将于 2024 年 Q2 量产 12 层 HBM3E，并搭载于 AMD（超微半导体）新一代 AI 半导体。随着其 HBM 客户扩大至超微，三星有望加速追赶 SK Hynix（SK 海力士）。

- **Micron Q2 拟对 DRAM 及 SSD 价格调涨 25%，存储产品价格将继续回暖**

据 DIGITIMES 报道，Micron（美光）计划 Q2 针对 DRAM 内存和 SSD（固态硬盘）产品调涨 25%。多家存储模组厂已获悉美光方面的调价意向，价格谈判仍在进行中。

- **存储原厂 Q2 计划扩产，关注存储芯片价格波动情况**

根据 Omdia 报告，Samsung（三星）已将今年 Q2 的平均每月 DRAM 晶圆投入量调升至 60 万片，环比增长 13%；预计下半年将 DRAM 晶圆投入量增加至 66 万片，DRAM 产量恢复到削减前的水平。SK Hynix（SK 海力士）将把每月平均 DRAM 晶圆投入量增加到 Q2 的 41 万片；下半年预计其 DRAM 晶圆投入量将增加至 45 万片。

（二）中期影响

- **Marvell 获得 AI 定制芯片订单，预计 AI 芯片市场竞争激烈**

Marvell（美满电子）表示，其已从三家美国大型云计算公司获得新 AI 芯片订单，到 2026 财年相关业务收入将达 25 亿美元，但其指出定制部门的利润率低于其他业务线。

- **Quanta 搭载 NVIDIA GB200 的服务器将于 9 月量产，持续看好 AI 服务器需求增长**

Quanta（广达）资深副总经理暨云达总经理杨麒令表示，搭载 NVIDIA（英伟达）GB200 的服务器将于 9 月量产。四大 CSP（云服务提供商）客户需求大，预计广达今年服务器出货量维持两位数增长。大型 CSP 厂商均相当看好全新英伟达 Blackwell 架构，需求量大，初期订单不小。

- **HANMI Semiconductor 获 Micron 226 亿韩元的 HBM 设备订单，看好 HBM 需求增长**

HANMI Semiconductor（韩美半导体）从 Micron（美光科技）获得价值 226 亿韩元订单，将提供用于制造 HBM 芯片的 TC 键合机。此外，韩美半导体 HBM 设备获得 SK Hynix（SK 海

力士) 的累计订单额已超过 2000 亿韩元。

(三) 长期影响

- **Samsung 开设实验室自研 AI 芯片，有望改变 AI 芯片行业格局**

据韩媒 Sedaily 报道，Samsung（三星电子）通过旗下三星综合研究院在美国硅谷开设面向人工智能芯片设计的先进处理器实验室。该实验室将专注于 RISC-V 架构处理器 IP 的设计工作，最终目标是打造基于 RISC-V 架构的自研人工智能芯片，打破 NVIDIA（英伟达）在人工智能芯片领域的霸权。

- **SK Hynix 将与 TSMC 合作量产 HBM4 芯片，看好 HBM 需求增长**

4 月 19 日，SK Hynix（SK 海力士）宣布，将与 TSMC（台积电）合作，自 2026 年开始量产 HBM4 芯片。在芯片制造难度上升的背景下，大型企业将携手合作，力争开发新一代产品并稳定供应。

- **SK Hynix 将扩大存储芯片产能，匹配 AI 长期需求**

SK Hynix（SK 海力士）拟斥资约 20 万亿韩元（146 亿美元）在韩国构建新的存储芯片产能，进行重大的产能升级，以满足人工智能需求。其于 4 月底左右开始建设一家新工厂或晶圆厂，计划在 25 年 11 月完工。

- **ROHM 旗下的 SiCrystal 与 STM 扩大 SiC 晶圆供应合同，看好 SiC 需求增长**

ROHM（罗姆）和 STM（意法半导体）宣布，罗姆旗下的 SiCrystal GmbH（简称“SiCrystal”）将扩大目前已持续多年的 150mm SiC 晶圆长期供应合同。扩大后的合同约定未来数年向意法半导体供应在德国纽伦堡生产的 SiC 晶圆，预计合同期间的交易额将超过 2.3 亿美元。

- **Microchip 收购 Neuronix AI Labs，看好 AI 需求增长**

Microchip（微芯科技）宣布收购 Neuronix AI Labs，以进一步增强在 FPGA 上部署高效人工智能边缘解决方案的能力。

- **Infineon 与 Amkor 合作运营芯片封测中心，加强在欧洲的后端制造业务**

Infineon（英飞凌）与 Amkor（安靠）近日宣布深化合作伙伴关系，加强在欧洲的外包后端制造业务版图，双方将在安靠的制造基地（位于葡萄牙波尔图）运营一个专用的芯片封测中心。该芯片封测中心预计将于 2025 年上半年开始运营，安靠将扩展其在波尔图的设施并运行生产线，提供专用的洁净室空间，英飞凌将提供现场团队以提供工程和开发支持。

三、终端市场动态

终端市场动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
人工智能	Microsoft (微软)	计划到 24 年底囤积 180 万块 GPU	AI 芯片需求有望高速增长
	OpenAI	将在日本半导体行业寻求合作伙伴，以采购 AI 所需高性能芯片	利好日本 AI 芯片产业发展
	SoftBank (软银集团)	计划在 2025 年前共投资约 9.6 亿美元来增强其 AI 数据中心的运算能力	AI 芯片需求有望持续增长
新能源	ElinEnergy	在美国德克萨斯州建立年产能 1GW 的太阳能组件制造工厂，计划扩大至 2GW	看好美国光伏市场需求增长
	JA Solar Technology (晶澳科技)	与比亚迪近日签署战略合作协议	国内储能产业加速发展
汽车	Hesai Technology (禾赛科技)	和 Momenta 在禾赛麦克斯韦智造中心签署战略合作协议	汽车智能化加速发展
	Mobileye	EyeQ6 Lite 自驾芯片接单量达 4,600 万颗	智驾芯片需求有望继续增长
	Volkswagen (大众汽车)	将投资 25 亿欧元进一步拓展合肥生产及创新中心	智能电动汽车需求有望继续增长
其他	Huawei (华为)	Pura 70 正式推出、销售火热	看好华为手机产业链机会
	Tata Group (印度塔塔集团)	收购和硕在印度的 iPhone 制造业务	看好 Apple 手机印度产业链机会

(一) 人工智能

● Microsoft 计划到 24 年底囤积 180 万块 GPU，AI 芯片需求有望高速增长

据报道，Microsoft（微软）内部计划在 2024 年将 GPU 数量增加两倍，目标到 2024 年末积累 180 万片 AI 芯片。到 2027 财年，微软预计将在 GPU 和数据中心上花费约 1000 亿美元。

● OpenAI 拟在日本采购 AI 领域芯片，利好日本 AI 芯片产业发展

OpenAI 公司将在日本半导体行业寻求合作伙伴，以采购人工智能所需的高性能芯片。近日，OpenAI 宣布在日本东京设立其在亚洲首个办事处，将业务扩展到亚洲，并将发布针对日语优化的 GPT-4 定制模型。

● SoftBank 计划投资 9.6 亿美元发展 AI 数据中心，AI 芯片需求有望持续增长

据报道，SoftBank（软银集团）计划在 2025 年前共投资 1,500 亿日元（约 9.6 亿美元）来增强其 AI 数据中心的运算能力。该投资包括向 NVIDIA（英伟达）购买 GPU，其中部分芯片用于自身 AI 研发，部分将租借给其他有需要的企业。目前，软银致力于开发专为日文设计的高性能生成式 AI。

（二）新能源

● ElinEnergy 赴美建厂，看好美国光伏市场需求增长

土耳其太阳能制造商 ElinEnergy 在美国德克萨斯州建立年产能 1GW 的太阳能组件制造工厂，计划扩大至 2GW。工厂以 SiriusPVUSA 品牌运营，已与美国主要分销商达成协议，并雇用 100 多名员工。

● 晶澳科技与比亚迪达成战略合作，加快储能产业发展

JA Solar Technology（晶澳科技）与比亚迪近日签署战略合作协议。本协议旨在充分整合双方资源及技术优势，在科研创新、供应链合作、全球市场开发等领域建立更加全面、深度的战略合作关系，联合开发先进的储能产品，提供全球领先的光储整体解决方案。

（三）汽车

● 禾赛科技与 Momenta 达成战略合作，推动汽车智能化发展

据 Hesai Technology（禾赛科技）最新披露，公司和 Momenta 在禾赛麦克斯韦智造中心签署战略合作协议。此次携手旨在深度整合双方优势资源，进一步拓宽产品战略布局，共同研发更多元化、更具竞争力的智能驾驶解决方案。

● Mobileye 芯片接单量已达 4600 万颗，智驾芯片需求有望继续增长

Mobileye 表示，EyeQ6 Lite 自驾芯片接单数量已达 4,600 万颗，看好未来几年的接单动能，可望推动后续业绩表现。

● Volkswagen 将投资 25 亿欧元拓展合肥生产及创新中心，加快智能电动汽车生产

Volkswagen（大众汽车）将投资 25 亿欧元进一步拓展合肥生产及创新中心，同时提速与小鹏汽车的智能电动车型生产。

（四）其他

● 华为 Pura 70 销售火热，看好华为手机产业链机会

Huawei（华为）Pura 70 正式推出、销售火热，其供应链基本已全部实现国产化，利好国产电子零部件厂商。其中，整机代工方面，有光弘科技、福日电子；硬件端来看，有 CIS 厂商思特威、韦尔股份，卫星通信基带芯片厂商华力创通，摄像头模组厂商舜宇光学、欧菲光。

● Tata Group 收购和硕在印度的 iPhone 制造业务，看好 Apple 手机印度产业链机会

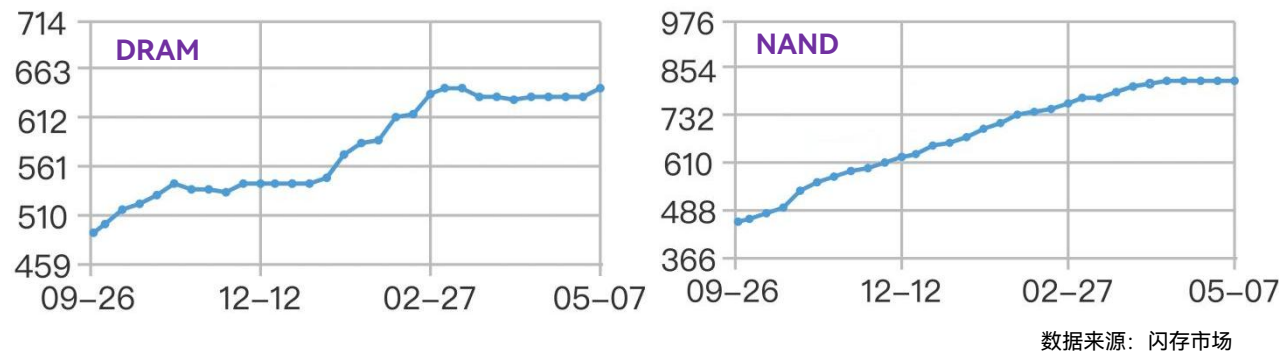
Tata Group（印度塔塔集团）最早可能于 5 月收购和硕公司在印度的 iPhone 制造业务，目前谈判已进入最后阶段。

四、重点产品行情

（一）存储芯片：终端需求增长放缓，现货价格增长动力不足

近期，原厂端价格仍在环比上涨，但由于终端需求增长放缓，现货市场价格增长相对持平，成交压力较大。

DRAM 及 NAND 价格指数



根据 TrendForce 最新预测，第二季度 DRAM 合约价季涨幅将上修至 13%-18%；NAND Flash 合约价季涨幅同步上修至约 15%-20%，全线产品仅 eMMC/UFS 价格涨幅较小，约 10%。

2024 年 DRAM 及 NAND Flash 合约价涨幅预测

产品类别	1Q24	2Q24 原先预估	2Q24 最新预测
Total DRAM	Up 20%	Up 3%-8%	Up 13%-18%
Total NAND Flash	Up 23%-28%	Up 13%-18%	Up 15%-20%

数据来源：TrendForce

另一方面，企业级 SSD 行情有所起色。为降低 AI 推理服务器能耗，北美客户对 QLC Enterprise SSD 需求开始提升。根据 TrendForce 预计，2024 年 QLC Enterprise SSD 出货位元将同比增长 4 倍。

2024 年 Enterprise SSD 合约价季度涨幅预测

1Q24	2Q24(E)	3Q24(F)	4Q24(F)
上涨 23-28%	上涨 20-25%	上涨 5-10%	基本持平

数据来源：TrendForce

（二）MCU：低端型号市价倒挂，车规类器件货期较长且稳定

通用类 MCU 需求仍然较弱，Microchip 低端型号市场价格倒挂，NXP 传统 MCU 交期较短。

汽车 MCU 需求仍然相对稳定。分市场来看，Infineon（英飞凌）的安全 MCU 几乎垄断智能驾驶领域，目前市场销售的多数车身域、底盘域、动力域控制器都采用英飞凌 TC2xx 系列、TC3xx 系列 MCU。TechInsights 数据显示，英飞凌以近 14% 的市场份额稳居全球汽车 MCU 市场榜首。

MCU 交期及价格趋势

产品类别	价格趋势	交期趋势
8 Bit MCU	→	→
16 Bit MCU	→	→
32 Bit MCU	→	→
Automotive MCU	→	→

数据来源：安富利

（三）模拟芯片：受益于消费电子市场弱复苏，Q2 订单有望恢复

近期，模拟芯片仍以消费电子市场为增长动能，根据 Canalys 数据，24 年 Q1 全球智能手机出货量同比增长 11%；全球 PC 出货量同比增长 3%。第二季度开始，工业、汽车行业需求或将有所复苏，TI（德州仪器）给予 Q2 业绩乐观预测，表明终端客户已恢复下单。

模拟芯片交期及价格趋势

产品类别	价格趋势	交期趋势
Amplifiers & Comparators	→	→
Analog Interface	→	→
Power Management	→	→
Converters	→	→
Total	→	→

数据来源：安富利

五、市场重点趋势

● 华为 Pura 70 手机销售火热，关注华为手机产业链机会

华为 Pura 70 系列新机上市后销售火热，TechInsights 分析师表示，预计 2024 年整个 Pura 70 系列销量将超过 1000 万台。根据 Fomalhaut Techno Solutions 的拆解报告指出，华为仅 Pura70 Ultra 主相机采用索尼零组件；其余 Pura70、Pura70 Pro、Pura70 Pro+等机型的核心处理器、面板、机壳、电池、镜头、散热、声学元件等零组件，几乎全面国产化。据悉，Pura 70 系列的主要供应商涵盖欧菲光、蓝思科技、歌尔声学、长盈精密、舜宇光学、京东方、水晶光电等企业。

- **终端需求疲软，中低端存储芯片现货价或将承压**

尽管存储原厂计划调涨产品价格，但终端市场需求仍然较为疲软，除了高端的 DDR4/DDR5 外，其他中低端存储产品现货价格或将承压。

信息来源

- [1]DRAM 厂陆续恢复生产，预估对第二季总 DRAM 位元产出影响低于 1%，TrendForce, 2024
- [2]Malaysia plans Southeast Asia's largest integrated circuit design park, Reuters, 2024
- [3]Microsoft invests in Arabic AI firm as U.S. tries to limit China's sway, Washington Post, 2024
- [4]法国经济部长：大规模采用“法国制造”光伏组件，索比光伏网 2024
- [5]日本将收紧对更多芯片和量子技术的出口管制, C114 通信网, 2024
- [6]西部数据确认 HDD 和 SSD 出现供应短缺, CFM 闪存市场, 2024
- [7]消息称三星 Q2 供应超微 HBM3E, 财联社, 2024
- [8]三星和 SK 海力士正在提高 DRAM 产量，将恢复至削减前水平，财联社, 2024
- [9]美光计划二季度针对 DRAM 内存和固态硬盘产品调涨 25%, DIGITIMES, 2024
- [10]获得新 AI 芯片订单, Marvell, 2024
- [11]搭载 NVIDIA GB200 的服务器将于 9 月量产，广达, 2024
- [12]韩美半导体从美光科技获得价值 226 亿韩元的订单,财联社, 2024
- [13]三星电子在美开设先进处理器实验室, Sedaily, 2024
- [14]SK 与台积电合作开发 HBM4，2026 年量产，日经中文网, 2024
- [15]SK 海力士计划在韩国增加 146 亿美元 AI 芯片投资, wsj.com, 2024
- [16]罗姆集团旗下的 SiCrystal 与意法半导体扩大 SiC 晶圆供应合同, ROHM, 2024
- [17]Microchip 收购 Neuronix AI Labs, 凤凰网, 2024
- [18]英飞凌与安靠宣布共建芯片封测中心，半导体产业网, 2024
- [19]微软目前正在疯狂囤货 GPU，目标在 2024 年 12 月前达到 180 万片, Business Insider, 2024
- [20]OpenAI 将在日本半导体行业寻求合作伙伴，以采购 AI 所需的高性能芯片，凤凰网, 2024
- [21]SoftBank will reportedly invest nearly \$1 billion in AI push, CNBC, 2024
- [22]又一家光伏组件企业赴美国建厂，北极星太阳能光伏网, 2024
- [23]晶澳科技与比亚迪汽车工业达成战略合作，晶澳科技, 2024
- [24]禾赛科技与自动驾驶公司 Momenta 达成战略合作，界面新闻, 2024
- [25]Mobileye set to ship at least 46 million new assisted driving chips, Reuters, 2024
- [26]大众中国：投资 25 亿欧元进一步拓展位于合肥的生产及创新中心，界面新闻, 2024
- [27]华为 Pura 70 突然开售，证券时报网, 2024
- [28]消息称 iPhone 组装厂和硕印度业务最快 5 月易主，国际电子商情, 2024
- [29]AI 需求推升，2024 全年 QLC Enterprise SSD 出货位元高速增长, TrendForce, 2024

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2024 年 5 月



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有8个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。



洞察行情 精准决策

